

POC-500シリーズ

4×PoE+、4×USB 3.0、およびMezIO™インターフェースを備えたAMD Ryzen™V1000 超小型組込みコントローラ



POC-515

POC-545

CE FC

主な機能

- AMD Ryzen™ 組み込みV1000シリーズクアドコア15W/45W CPU
- 堅牢、-25℃~70℃のワイド温度動作
- スクリューロック付きギガビットPoE+ 4ポート
- ネジロック付きの4つのUSB 3.0ポート
- 高速ストレージアクセス用のM.2 2280 MキーNVMe (Gen3 x2) ソケット
- DP + VGAデュアルディスプレイ出力
- フロントI/OアクセスとDINレール取り付け設計
- MezIO™互換

概要

POC-500シリーズは、このフォームファクタでこれまでにないパフォーマンスを提供する次世代の超小型組込みコントローラです。AMD Ryzen™エンベデッドV1000 4コア/8スレッドプロセッサを搭載し、以前のPOCシリーズの最大3倍のCPUパフォーマンスを実現します。GPUの性能面では、FP16でこれまでにない3.6 TFLOPSの超小型フォームファクタエンベデッドコントローラを実現します。もう一つの素晴らしい機能は、標準の2.5インチSATA SSDの2倍のディスク読み取り/書き込み速度をサポートするために、M.2 2280 NVMe SSD (PCIe Gen3 x2) を組み込んだことです。

POC-500シリーズは、POCシリーズの独自のDINレール取り付け機構設計を引き継ぎ、前面からアクセス可能な多くのI/Oを提供します。たった63×176×116 mm (2.5"×6.9"×4.6")のコンパクトサイズで、4つのPoE+ポート、4つのUSB 3.0ポート、4つのCOMポートを備えています。CPUは2種類提供されており、V1807B (45W) は高いコンピューティング電力需要向けで、V1605B (15W) は堅牢なファンレス動作向けに設計されています。

仕様



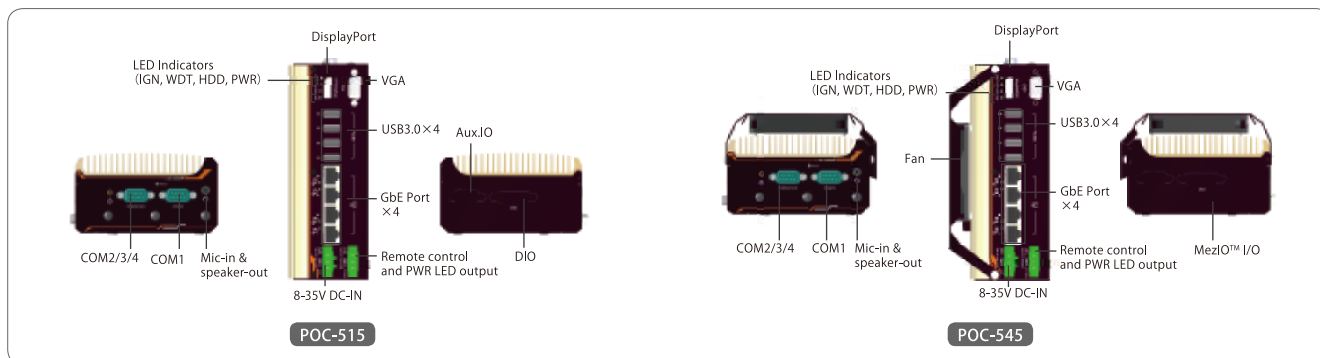
	POC-515	POC-545
システムコア		
プロセッサ	AMD Ryzen™ V1605B CPU (4C/8T、2Mキャッシュ、2.0/3.6GHz、12W - 25W TDP)	AMD Ryzen™ V1807B CPU (4C/8T、2Mキャッシュ、3.35/3.8GHz、35W - 54W TDP)
グラフィックス	8 Compute Unit搭載のVega GPU	11 Compute Unit搭載のVega GPU
メモリ	1つのSODIMMソケットに対して最大16 GB DDR4-2400 SDRAM	1つのSODIMMソケットに対して最大16 GB DDR4-3200 SDRAM
パネルI/Oインターフェース		
PoE+	IEEE 802.3at PoE+ ポート #1~4	
USB	スクリューロック付き 4×USB3.0ポート	
ビデオポート	1920×1200解像度をサポートする 1× VGAコネクタ 4096×2160解像度をサポートする 1× DisplayPortコネクタ	
シリアルポート	1×ソフトウェアプログラマブルな RS-232C/422/485 ポート (COM1) 3×3線式RS-232Cポート (COM2/3/4) または 1× RS-422/485ポート (COM2)	
オーディオ	マイク入力およびスピーカ出力用 1×3.5mmジャック	
内部I/Oインターフェース		
Mini-PCIe	1× 内蔵SIMソケット付フルサイズ mini PCIエクスプレスソケット	
拡張可能なI/O	1× Neosys MezIO™用 MezIO™拡張ポート	
ストレージインターフェース		
M.2 NVMe	NVMe SSDインストール用の1×M.2 2280 MキーNVMeソケット (PCIe 第3世代 ×2)	

	POC-515	POC-545
電源供給		
DC入力	1× 8~35VDC DC入力用の3ピン プラガブル端子台	
リモートコントロール & LED出力	1× リモートコントロールおよびPWR LED出力用の3ピン プラガブル端子台	
メカニカル		
寸法	64(W) × 116(D) × 176(H) mm	81(W) × 118(D) × 176(H) mm
重量	1.2 kg	1.4 kg
取付	壁取り付け(標準) およびDINレール取り付け(オプション)	
ファン	—	システム放熱用の外部アクセス可能な80mm×80mmファン
環境		
動作温度	-25℃ ~ 70℃ */**	
保管温度	-40℃ ~ 85℃	
湿度	10%~90%、結露なきこと	
振動	操作中、MIL-STD-810G、方法514.6、カテゴリ4	
衝撃	操作中、MIL-STD-810G、方法516.6、手順I、表516.6 II	
EMC	EN55032 および EN55024に準拠した CE/FCCクラスA	

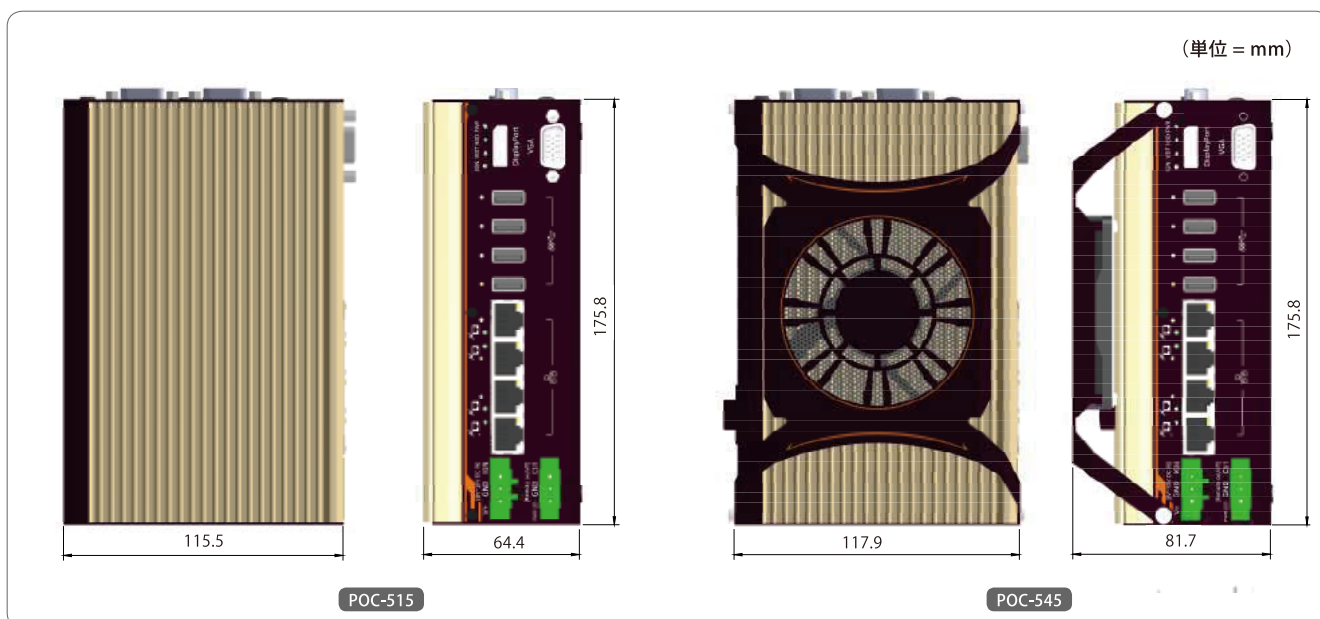
* サブゼロおよび60℃を超える動作温度では、ワイド温度HDDまたはソリッドステートディスク(SSD)が必要です。

** POC-545の場合、外付けファンが取り付けられている場合に限り、動作温度は最大70℃です。

外観



寸法



オーダー情報

Model No.	Product Description
POC-515	4×PoE+, 4×USB 3.0, およびMezIO™インターフェースを備えたAMD Ryzen™ V1605B 超小型組込みコントローラ
POC-516	4×PoE+, 4×USB 3.0, およびMezIO-R12を備えたAMD Ryzen™ V1605B 超小型組込みコントローラ
POC-545	4×PoE+, 4×USB 3.0, およびMezIO™インターフェースを備えたAMD Ryzen™ V1807B 超小型組込みコントローラ
POC-546	4×PoE+, 4×USB 3.0, およびMezIO-R12を備えたAMD Ryzen™ V1807B 超小型組込みコントローラ